

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	SRAM	発行番号	TN-M62-B001A/J	Rev.	第1版
題名	1Mb 低消費電力 SRAM(5V品)32pin SOP品： R1LP0108ESP品のリードフレーム母材変更に関するご連絡。		情報分類	パッケージ変更	
適用製品	R1LP0108ESN-5SI R1LP0108ESN-7SI R1LP0108ESN-5SR R1LP0108ESN-7SR	対象ロット等	関連資料	なし	
		'13/12以降出荷 分より順次			

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて弊社では 1Mb 低消費電力 SRAM(5V品)32pin SOP品：R1LP0108ESP シリーズ(リードフレーム母材：Fe-Ni 42Alloy)のリードフレーム母材変更を以下のスケジュールにて進めさせて頂く予定ですので、主旨ご理解の上、リードフレーム母材変更品：R1LP0108ESN シリーズ(リードフレーム母材：Cu)への早期ご承認を賜りますよう、ご協力の程よろしく申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 変更内容：

1Mb 低消費電力 SRAM(5V品)32pin SOP品：R1LP0108ESP シリーズのリードフレーム母材変更
 R1LP0108ESP シリーズ(リードフレーム母材：Fe-Ni 42Alloy)から R1LP0108ESN シリーズ(リードフレーム母材：Cu)への切替

2. 概要：

リードフレーム母材：Fe-Ni 42Alloy から Cu への変更により実装信頼性の向上を図ってまいります。

- ・パッケージの外形寸法は、リードフレーム母材によらず同一です。
- ・製品の電気的特性は、リードフレーム母材によらず同一です。
- ・リードフレーム母材の変更に伴い

リードフレーム処理が Sn-Cu めっき(リードフレーム母材：Fe-Ni 42Alloy)から Sn めっき(リードフレーム母材：Cu)

製品防湿性能が MS Level 2(リードフレーム母材：Fe-Ni 42Alloy)から MS Level 3 リードフレーム母材：Cu)に変更になります。

3. ご承認に関する資料・評価サンプルのご案内：

データシート	： 正式版(発行済)
動作確認サンプル	： 2013年6月(対応済)
信頼度保証サンプル	： 2013年6月(対応済)
信頼度資料	： 2013年6月末

4. 切替時期：

2013年12月出荷分より順次切り替え予定。
 上記スケジュールに不都合がある場合は2013年9月まで弊社にご連絡願います。

5. リードフレーム母材変更製品の推奨型名一覧表：

型名	リードフレーム母材	アクセスレイト*	温度保証範囲	型名	リードフレーム母材
R1LP0108ESP-5SR	Fe-Ni 42Alloy	55ns	0°C~70°C	R1LP0108ES N -5SR	Cu
R1LP0108ESP-7SR		70ns		R1LP0108ES N -7SR	
R1LP0108ESP-5SI		55ns	-40°C~85°C	R1LP0108ES N -5SI	
R1LP0108ESP-7SI		70ns		R1LP0108ES N -7SI	

6. リードフレーム母材変更に伴うリードフレーム処理及び製品防湿性能の変更

型名	リードフレーム母材	リードフレーム処理	製品防湿性能
R1LP0108ESP-5SR	Fe-Ni 42Alloy	Sn-Cu めっき	MS Level2 保管条件: 30°C,70% RH 以下
R1LP0108ESP-7SR			
R1LP0108ESP-5SI			
R1LP0108ESP-7SI			



型名	リードフレーム母材	リードフレーム処理	製品防湿性能
R1LP0108ES N -5SR	Cu	Sn めっき	MS Level3 保管条件: 30°C,70% RH 以下
R1LP0108ES N -7SR			
R1LP0108ES N -5SI			
R1LP0108ES N -7SI			